

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2018-010

深圳丹邦科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 547920000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丹邦科技	股票代码	002618
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	莫珊洁		
办公地址	广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼		
电话	0755-26511518、0755-26981518		
电子信箱	msj@danbang.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业，包括FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品及关键配套材料聚酰亚胺薄膜（PI膜）的研发、生产与销售。

FPC（Flexible Printed Circuit Board）即柔性印制电路板，是连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介。COF 柔性封装基板作为FPC的高端分支产品，指还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板，在芯片封装过程中，起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用，特别是对芯片起到物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓和、散热防潮

的作用。COF产品（Chip on flexible printed circuit）是用COF柔性封装基板作载体，将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。公司主营产品主要应用于空间狭小，可移动折叠的高精尖智能终端产品，在消费电子、医疗器械、特种计算机、智能显示、高端装备产业等微电子领域都得到广泛应用。公司主要生产经营模式为“以单定产”，即根据客户的订单情况来确定生产计划。

聚酰亚胺薄膜（PI膜）是一种新型的耐高温有机聚合物薄膜，按照用途分为一般绝缘和耐热为主要性能指标的电工级和赋有高挠性、低膨胀系数等性能的电子级。用于电子信息产品中的电子级PI薄膜作为特种工程材料具有其他高分子材料所无法比拟的高耐热/氧性能、优良的机械性能、电性能及化学稳定性，被称为“黄金薄膜”。目前微电子级PI膜最大的应用市场是作为柔性印制电路板（FPC）的基板材料—挠性覆铜板（FCCL）用重要的绝缘基材。公司非公开发行募集资金投资项目PI膜项目的顺利实施有助于公司的产业链进一步向上游延伸，最终形成“PI膜→FCCL→FPC”、“PI膜→FCCL→COF柔性封装基板→COF产品”的全产业链结构。项目达产后，一方面，公司将自用部分PI膜，从而减少相应的原材料外部采购，显著提高利润率；另一方面，公司PI膜对外销售，形成新的利润增长点。PI膜项目主要采用直销和经销相结合的销售模式。

柔性印制电路板需求由下游终端电子产品需求所主导，其中智能手机和平板电脑的需求量最大。随着下游终端电子产品不断更新换代，全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展。其中，以智能手机、平板电脑、车载电子等移动电子设备为首的消费类电子产品市场高速增长，极大地推动了作为其主要连接配件的FPC市场发展。另外，可穿戴智能设备、无人机等新兴消费类电子产品市场的快速兴起也为FPC产品带来新的增长空间。同时，各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得FPC借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入到了更为广阔的应用空间。

微电子级PI膜主要应用于FCCL的制造及作为PI膜深加工产品的前驱体材料。聚酰亚胺及其深加工产品具有广阔的应用前景和巨大的商业价值，是微电子封装领域关键的配套材料，在微电子封装技术发展进程中具有决定性的作用和重要的基础地位、先行地位和制约地位。目前，微电子工业已经取代传统的电气绝缘行业成为聚酰亚胺材料尤其是薄膜的最大应用领域。采用高分子烧结法制备的PI碳化膜属于PI膜深加工产品，其优异的导热、导电、导声及电池屏蔽与隐身等性能，将在柔性半导体器件、芯片高效散热、柔性显示、柔性太阳能发电等领域大放异彩。

公司的行业地位突出，作为国内高端柔性印制电路板行业的领先者，技术水平在国内居领先水平，接近国际尖端水平。公司坚持实施高端产品竞争战略，通过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争能力不断增强，已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构，是全球极少数掌握微电子级PI膜、高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	317,158,467.26	270,756,688.83	17.14%	419,038,000.40
归属于上市公司股东的净利润	25,373,613.21	24,589,944.57	3.19%	66,869,539.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,400.82	21,954,644.17	-99.54%	60,528,916.11
经营活动产生的现金流量净额	212,631,765.38	138,973,671.45	53.00%	40,557,325.82
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%	0.37
加权平均净资产收益率	1.51%	1.48%	0.03%	4.13%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,590,785,519.58	2,371,828,621.26	9.23%	2,386,696,863.38
归属于上市公司股东的净资产	1,692,763,139.48	1,669,560,886.00	1.39%	1,651,439,930.10

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	75,334,317.30	73,998,102.21	79,688,854.51	88,137,193.24

归属于上市公司股东的净利润	7,928,668.10	3,694,495.96	5,152,350.19	8,598,098.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,191,526.99	3,392,496.20	4,687,570.19	-12,171,192.56
经营活动产生的现金流量净额	-10,489,038.18	26,745,026.03	-4,255,931.66	200,631,709.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

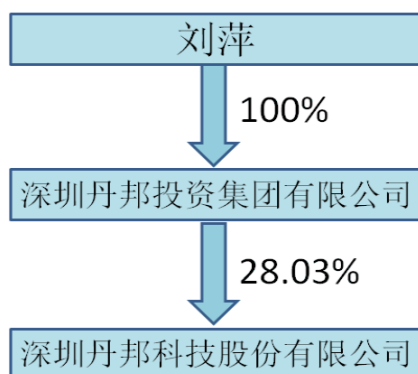
报告期末普通股股东总数	23,734	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	28.03%	153,598,000	0			
深圳市丹依科技有限公司	境内非国有法人	6.82%	37,369,950	0			
陈颖	境内自然人	2.39%	13,083,405	0			
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽4号私募基金	其他	2.00%	10,958,000	0			
蒋亦飞	境内自然人	1.55%	8,504,100	0			
汪涓	境内自然人	1.27%	6,945,500	0	质押	160,500	
邓成	境内自然人	1.24%	6,781,880	0	质押	6,686,780	
李葛卫	境内自然人	1.21%	6,650,000	0			
李正芳	境内自然人	1.21%	6,640,500	0			
林培	境内自然人	0.95%	5,231,956	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹依科技有限公司主要股东刘文魁为叔侄关系；2、除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中，陈颖通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 8,211,435 股；蒋亦飞通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 8,416,200 股；汪涓通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 2,625,000 股；李葛卫通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 6,650,000 股；李正芳通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 6,640,500 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年我国经济发展平稳，但行业经济仍有下行压力，面临竞争加剧、上游原材料价格上涨、环保政策进一步趋严等一系列挑战。报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”实现量产，其产能释放进度处于缓慢爬坡阶段，固定资产折旧较大，新产品、新项目的研发和建设也带来融资及其它财务成本的上升，加上人民币兑美元汇率波动对业绩的影响，公司2017年存在较大的经营压力。

报告期内，2017年公司全年实现营业收入31,715.85万元，同比上涨17.14%；实现利润总额3062.60万元，同比上涨16.67%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,537.36万元，同比上涨3.19%，本期净利润率8.00%，低于上年同期。截止2017年年底，公司资产总额为259,078.55万元，归属于股东的净资产为169,276.31万元，资产负债率34.66%；经营活动产生的现金流量净额为21,263.18万元。

2017年公司主要开展了以下生产经营工作：

(一) 首发募投项目

报告期，公司努力突破传统工艺制作微细线路工艺及封装水平，进一步提升产品关键性能指标，更好地适应当今电子产品小型化、薄型化、轻量化的发展趋势。为满足不同的微电子封装需求，自主研制了COF基板及封装配套材料，如：阻焊油墨、黑孔液、底部填充胶等，取得“一种液晶型环氧底部填充胶及其制备方法”、“用于印制电路板的黑孔液及其制备方法”、“FPC用碱显影感光阻焊油墨、制备方法、用途及产品”等9项专利技术。

(二) “微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目

2017年1月13日，微电子级PI膜项目成果通过深圳市高新技术产业协会主持的技术鉴定，取得成果登记证书。2017年4月，公司微电子级PI膜生产线建成开始生产，公司积极融合全新工业4.0理念，在产品的各项性能指标达到公司内部标准的基础上，继续完善设备配置，提升量产工艺的稳定性 and 产品质量，逐步实现产能爬坡。

(三) TPI薄膜碳化技术改造项目

依托公司自产化学法微电子级PI膜的优势，公司对PI碳化膜方面展开深入研究，拟通过高分子烧结法制备PI碳化膜产品，实现柔性多层石墨烯结构的量子碳基薄膜材料，同时开发PI碳化膜的R-R自动化生产工艺。目前，已经完成碳化膜样品的开发及性能测试等前期工作，进入产业化准备阶段。

(四) 国家02重大专项“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目

由广东丹邦科技有限公司承担的02专项项目“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”（项目编号：2011ZX02710）历经专家组多次实地检查、现场测试、资料审查、内部验收及正式验收前的现场复查等系列检查后于2017年4月13日通过了正式验收。

(五) 整合资源, 提升经营管理效率

报告期内, 公司积极地将已有的资源进行合理调配和整合, 销售体系根据市场需求不断调整, 强调销售质量; 生产体系通过创新和智能化改造, 提升生产效率, 降低生产成本; 持续技术提升、研发创新, 保证产品的市场竞争力; 企业管理工作突出安全保证, 成本控制和服务意思, 为企业的发展保驾护航。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
FPC	50,118,783.43	17,306,897.63	34.53%	-6.41%	0.63%	2.41%
COF 柔性封装基板	155,002,594.74	57,581,998.73	37.15%	12.45%	11.25%	-0.40%
COF 产品	98,530,540.57	38,318,785.02	38.89%	29.53%	36.41%	1.96%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定, 采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
自2017年1月1日发生的政府补助, 与企业日常活动有关的计入“其他收益”, 与企业日常活动无关的计入营业外收入。	调增合并利润表其他收益本期金额26,162,847.25元, 调减合并利润表营业外收入本期金额26,162,847.25元。 调增利润表其他收益本期金额3,218,374.98元, 调减利润表营业外收入本期金额3,218,374.98元。

(2) 本公司自 2017年5月28日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定, 采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额25,373,613.21元、上期金额24,589,944.57元。

	增加利润表“持续经营净利润”本期金额-6,865,317.02元、上期金额9,852,761.69元。
--	---

(3) 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	调减合并利润表“资产处置收益”本期金额0.00元，上期金额33,720.96元；调减合并利润表“营业外支出”本期金额0.00元，上期金额33,720.96元。调减利润表“资产处置收益”本期金额0.00元，上期金额29,443.22元；调减利润表“营业外支出”本期金额0.00元，上期金额29,443.22元。
非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。	无

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司出资设立深圳光明新区丹邦科技有限公司，于2017年6月15日办妥工商设立登记手续，并取得《企业法人营业执照》。注册资本100,000,000.00元，本公司占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳丹邦科技股份有限公司

董事长：刘萍

二〇一八年四月二十七日